



FLUX DE BRASAGE A BASE D'EAU ET SANS NETTOYAGE PACIFIC 2010F "VOC FREE"

Description:

Interflux[®] Electronics a spécialement développé le flux Pacific 2010F, de type "VOC-free", sans alcool, à base d'eau, pour l'industrie électronique afin de répondre positivement à la norme ISO 14000. Particulièrement adapté au fluxeur mousse ou en spray. Le flux Pacific 2010F s'utilise avec les alliages Sn63Pb37 mais également avec les alliages sans plomb. Il résiste bien aux températures de préchauffage élevées, et également au long temps de contact avec une vague ayant une température élevée.

Interflux[®] Electronics élabore toujours ses flux à base d'une chimie organique. Cette technique permet une totale évaporation des activants composant les flux lors du contact des vagues avec le circuit imprimé. Ainsi, nous pouvons obtenir des cartes électroniques extrêmement propres et sans résidus.

Pourquoi utiliser un flux "VOC-free"?

Le flux est ininflammable.

Ne dégage aucun composé organique volatil.

Supprime toutes les odeurs d'alcool dans les ateliers de production.

Plus besoin d'utiliser de diluant.

Elimine les contrôles d'acidité liés à l'évaporation des flux à base d'alcool.

Améliore la soudabilité et la propreté.

Diminue et simplifie les frais de transport, de stockage et d'assurance.

Réduit la consommation d'environ 30 %.

Parfaitement compatible avec le brasage sans plomb.

Caractéristiques physiques et chimiques :

Densité à 20°C:	1.00 g/ml ± 0.01
Couleur:	incolore
Odeur:	pas d'odeur
RNV % w/w:	2.5% ± 0.15
Présence d'halogène:	0%
Point éclair (TOC):	aucun
Indice d'acide:	16 mg KOH/g ± 2
Durée de vie:	1 an en conditions fermées

Conditionnement:

Bidon de polyéthylène de 10 litres.

Bidon de polyéthylène de 25 litres.

Bidon de polyéthylène de 200 litres.



Comment utiliser le PACIFIC 2010 F dans votre process de brasage ?

1. S'assurer que le fluxeur est parfaitement propre et ne contient plus de résidus du flux précédent.
2. Remplir votre fluxeur au niveau habituel.
3. Ajuster votre pression d'air jusqu'à l'obtention d'une fine mousse sur le dessus de la buse du fluxeur, tout en évitant tout débordement du bac principal.
4. Pour vérifier si la vitesse d'écoulement de la mousse est suffisante, il vous suffit de souffler dans la mousse et de vérifier que la mousse ne s'écrase pas trop et surtout qu'elle se reconstitue rapidement. Ce test peut être assimilé au passage d'un cadre (ou d'un masque) chaud sur la mousse. Si la mousse ne se constitue pas rapidement, vous risquez un mauvais fluxage sur le début du circuit imprimé et donc de générer des défauts (ponts, filament d'étain/plomb, ou alliages sans plomb ou des scories).
5. Dans le cas où le flux a été stocké à des températures inférieures à celles de la température ambiante (environ 20°C), nous vous informons que la qualité de la mousse peut changer et nous vous conseillons d'attendre que le flux ait atteint la température ambiante.
6. Utiliser toujours un couteau d'air dans l'application des flux « VOC free »!
(disponible chez Interflux)
Raisons :
 - pour éliminer les excès de flux et faciliter l'évaporation du flux et réduire les consommations;
 - pour favoriser la remontée du flux dans les trous de métallisation (les flux « VOC free » ont moins de pouvoir de capillarité que les flux à base d'alcool).
7. Réglez le préchauffage afin d'obtenir une température (mesurée sur le dessus du circuit imprimé) de 110°C à 130°C pour les alliages avec plomb et de 130°C à 150°C pour les alliages sans plomb. Cette température doit être atteinte avant le contact avec les vagues. Le circuit imprimé doit être le plus sec possible.
8. Dans le cas où vous constatez la présence de micro-billes sur le dessus du circuit imprimé, nous vous conseillons d'augmenter la température de préchauffage ou/et de réduire la vitesse du convoyeur.
9. Le temps de contact de la vague CMS doit être inférieur à 2 secondes.
10. Le temps de contact de la vague lisse doit être entre 2 et 5 secondes.
11. Dans le cas du brasage de circuit imprimé en Ni/Au, nous vous conseillons, si cela est nécessaire, d'augmenter le temps de contact jusqu'à environ 6 secondes.



12. La vague CMS et la vague lisse doivent être réglées de façon que la distance entre les buses et le composant le plus long soit de 2 mm.
13. Evitez de braser avec une vague et un bain d'étain/plomb chargé en impuretés et en scories. L'obtention d'une brasure de qualité dépend aussi de la propreté du bain (nous consulter pour le traitement et le nettoyage des bains d'étain/plomb).
14. L'utilisation d'un flux sans nettoyage nécessite impérativement d'avoir une vague lisse bidirectionnelle, c'est-à-dire que les oxydes présents sur la surface de la vague doivent être poussés à l'arrière lors du passage du circuit imprimé.
15. La vitesse d'écoulement des oxydes (appelé drainage) doit être égale à la vitesse de déplacement du circuit imprimé et donc du convoyeur.
16. Comment vérifier ceci :
Quand le circuit imprimé rentre en contact avec la vague lisse, les oxydes de surface doivent commencer à s'évacuer vers l'arrière, si on arrête le circuit imprimé, les oxydes doivent arrêter de s'évacuer. Ainsi on considère que la vitesse de déplacement du circuit imprimé est égale à la vitesse du drainage.
17. L'obtention du réglage comme défini ci-dessus permet d'éliminer toute vitesse relative entre le circuit imprimé et la vague lisse, ainsi les joints de brasage se formeront par gravité verticale et nous éviterons la formation de ponts de brasure.
18. S'assurer que le contact du circuit imprimé dans les vagues est un contact franc, c'est-à-dire que l'épaisseur du circuit imprimé doit toucher les vagues sur une hauteur d'au moins 30 %. Ainsi, vous obtiendrez un bon drainage mais aussi un excellent transfert de température des vagues vers le circuit imprimé. La qualité du brasage et la propreté en seront nettement améliorés.
19. Dans le cas d'un équipement de brasage sous azote, le drainage n'est pas indispensable, dû à l'absence d'oxydes de surface.
20. L'angle de convoyage doit être réglé entre 6° et 7°.
21. Il est conseillé d'utiliser environ 70 % de la largeur totale de la vague lisse.
22. Evitez, si possible, toute forme de flambage du circuit imprimé car il peut créer des temps de contact variables. Prévoir des cadres de brasage si nécessaire.
23. Utiliser les réglages mis à votre disposition par les équipements de brasage : vitesse de convoyeur, préchauffage, temps de contact vague, etc...

Interflux[®] Electronics vous souhaite une excellente mise en route avec le flux Pacific 2010F type « VOC free ».

Si vous avez des questions, veuillez nous contacter.